

通 知

有關 2014 年「台灣半導體產業協會 TSIA 獎」已開始申請。請
貴院於 104 年 1 月 7 日 (三) 前，將便簽與推薦學生申請資料送本組
彙辦 (如無人申請亦請務必回覆信箱或電話告知)，謝謝。

此致

理學院

工學院

電資學院

擬公告各網頁

理學院地質系
幹事 廖子文

1025

如擬

理學院地質系
學系系主任 鄧茂華

1025

擬：轉請各系所推薦，
博士生及博士後
研究生各至多推薦
一名。

學生事務處生活輔導組 敬啟

二、請於 104 年 1 月 5 日
前送院彙辦。

理學院 李惠靜

理學院 秘書 李明英
理學院 院長 劉緒宗



承辦人：李進成生活輔導組 曾肖儒
電話：(02) 3366-2050
信箱：srzeng@ntu.edu.tw

★注意事項：

1、依該會獎學金來文及辦法，每校最多推薦 10 名博士生、3 名博士後研究員。

2、博士生各院名額：

依照 102 學年度推薦名單：工學院 1 名、電資學院 7 名，總計 8 名。

今年推薦名額分配則依 102 學年度之推薦名單做比例調整：

理學院 (1 名正取、1 名備取)

工學院 (1 名正取、1 名備取)

電資學院 (6 名正取、2 名備取)

3、博士後研究生名額：每院 1 名，共計 3 名。

2013

國立交通大學

2015 TSIA 博士後研究員半導體獎申請辦法

民國一〇三年十一月二十六日修訂

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出博士後研究員積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者，特訂定本辦法。

二、獎項：

「TSIA 博士後研究員半導體獎」一至二名，頒給獎牌乙座、並將其個人貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉及獎金新台幣 8 萬元整。

三、申請資格：

3-1 103 年度將從國立台灣大學、國立清華大學、國立交通大學與國立成功大學共四所大學之博士後研究員中進行推薦，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

3-2 經指導教授推薦者。

四、申請時間：

本會於 2014 年 12 月中旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為 2014 年 12 月 15 日至 2015 年 1 月 15 日止。

五、遴選委員會

由台灣半導體產業協會理事長為遴選委員會主委，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於 2015 年 3 月之本會年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

八、推薦方式：

8-1 各校可推薦最多 3 名博士後研究員，TSIA 遴選委員會針對各校推薦名單進行兩次評

選：初選於各校名單中各選出 1 名為候選人；複選時，採共同競賽，選出 1~2 名傑出博士後研究員，即為得獎人。若複選仍無法選出得獎人，則增加口試會議定之。

8-2 若上述申請推薦內容或過程中，有違反事實之情事發生並經查明屬實，本會得撤銷其獲獎資格及獎項。

九、申請文件：

9-1 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。

9-2 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。

9-3 身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內)。

9-4 博士班修習期間成績單正本。

9-5 工作服務證明正本。

9-6 參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。

9-7 檔案光碟一份，請將上述文件掃描為單一檔案後，燒錄於光碟內，以利建檔。

十、遴選方式：

由 TSIA 遴選委員會執行。

十一、其它：

本申請辦法由遴選委員會訂定，經 TSIA 理監事會核備後實施，日後若有修訂，亦同。

十二、若有未盡事宜，本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

十三、聯絡資訊：

林永隆 TSIA 遴選委員會總幹事/國立清華大學教授

電話：(O) 03-573-1072

地址：新竹市 30013 光復路二段 101 號

國立清華大學 資訊工程學系

Email Address: ylin@cs.nthu.edu.tw

附件一、「2015 TSIA 博士後研究員半導體獎」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱	(中文)		
	(英文)		
系所名稱	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址			
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、參與學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟： (若欄位不足，請自行新增。)

事蹟名稱	主辦單位	時間(西元年/月/日)	概述

五、可供徵詢之專家資料

姓名	服務單位/職稱	電話(公司/手機)	Email	與申請人之關係

六、自傳(500字內)

七、自述研究成果或貢獻及其重要性(500字內)

八、身份證正反面影本

<p>身份證正面黏貼處</p>	<p>身份證反面黏貼處</p>
------------------------	------------------------

九、應備文件點檢表：

項目	請打“v”	文件名稱
9-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
9-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
9-3		身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
9-4		博士班修習期間成績單正本。
9-5		工作服務證明正本。
9-6		參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
9-7		檔案光碟一份，請將 9-1~9-6 文件掃瞄為單一檔案後，燒錄於光碟內，以利建檔。

附件二、「2015 TSIA 博士後研究員半導體獎」推薦函

一、被推薦人資料

學校		系所	
姓名		生日	西元 年 月 日
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			

二、推薦人資料

任職機構		任職部門	
姓名		職稱	
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			
與被推薦人的關係			

三、推薦理由

推薦人簽名：

日期： 年 月 日

2015 TSIA 博士研究生半導體獎申請辦法

民國一〇三年十一月二十六日修訂

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出博士研究生積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者，特訂定本辦法。

二、獎項：

「TSIA 博士研究生半導體獎」四名，每名頒給獎牌乙座、並將其個人貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉及獎金新台幣 8 萬元整。

三、申請資格：

3-1 103 年度將從國立台灣大學、國立清華大學、國立交通大學與國立成功大學共四所大學之博士研究生中進行推薦，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

3-2 已通過博士資格考之博士班研究生。

3-3 經指導教授推薦者。

四、申請時間：

本會於 2014 年 12 月中旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為 2014 年 12 月 15 日至 2015 年 1 月 15 日止。

五、遴選委員會

由台灣半導體產業協會理事長為遴選委員會主委，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於 2015 年 3 月之本會年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

八、推薦方式：

- 8-1 各校依第三項規定向本會推薦最多 10 名博士研究生。TSIA 遴選委員會針對各校推薦名單進行兩次評選：初選於各校名單中各選出 3 名為候選人；複選於各校候選人中各選出 1 名傑出博士研究生，共計 4 名，即為得獎人。若複選仍無法選出得獎人，則增加口試會議定之。
- 8-2 若上述申請推薦內容或過程中，有違反事實之情事發生並經查明屬實，本會得撤銷其獲獎資格及獎項。

九、申請文件：

- 9-1 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
- 9-2 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
- 9-3 學生證及身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內)。
- 9-4 博士班修習期間成績單正本。
- 9-5 參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
- 9-6 檔案光碟一份，請將上述文件掃描為單一檔案後，燒錄於光碟內，以利建檔。

十、遴選方式：

由 TSIA 遴選委員會執行。

十一、其它：

本申請辦法由遴選委員會訂定，經 TSIA 理監事會核備後實施，日後若有修訂，亦同。

十二、若有未盡事宜，本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

十三、聯絡資訊：

林永隆 TSIA 遴選委員會總幹事/國立清華大學教授
電話：(O) 03-573-1072
地址：新竹市 30013 光復路二段 101 號
國立清華大學 資訊工程學系
Email Address: ylin@cs.nthu.edu.tw

附件一、「2015 TSIA 博士研究生半導體獎」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱	(中文)		
	(英文)		
系所名稱	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址			
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、參與學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟： (若欄位不足，請自行新增。)

事蹟名稱	主辦單位	時間(西元年/月/日)	概述

五、可供徵詢之專家資料

姓名	服務單位/職稱	電話(公司/手機)	Email	與申請人之關係

六、自傳(500字內)

七、自述研究成果或貢獻及其重要性(500字內)

八、學生證正反面影本

<p>學生證正面黏貼處</p>	<p>學生證反面黏貼處</p>
------------------------	------------------------

九、身份證正反面影本

<p>身份證正面黏貼處</p>	<p>身份證反面黏貼處</p>
------------------------	------------------------

十、應備文件點檢表：

項目	請打"v"	文件名稱
9-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
9-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
9-3		學生證及身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
9-4		博士班修習期間成績單正本。
9-5		參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
9-6		檔案光碟一份，請將 9-1~9-5 文件掃描為單一檔案後，燒錄於光碟內，以利建檔。

附件二、「2015 TSIA 博士研究生半導體獎」推薦函

一、被推薦人資料

學校		系所	
姓名		生日	西元 年 月 日
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			

二、推薦人資料

任職機構		任職部門	
姓名		職稱	
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			
與被推薦人的關係			

三、推薦理由

推薦人簽名：

日期： 年 月 日

